

レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating to Fill Laser Through-hole

トッフルチナLTF

TOP LUCINA LTF

- 低膜厚でスルーホールフィリングを実現
Realize through-hole filling by thin thickness
- 低膜厚化によって配線の微細化に対応
Applicable to micro-patterning by thin thickness
- コア基板形成の工程簡略化が可能
Can reduce treatment steps by forming core substrates
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能
Quantitative analysis is possible for all additives

低膜厚でスルーホールフィリングを実現

Realize through-hole filling by thin thickness

硫酸銅五水和物

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

230g/L

硫酸

H_2SO_4

70g/L

塩化物イオン

Cl^-

30mg/L

電流密度

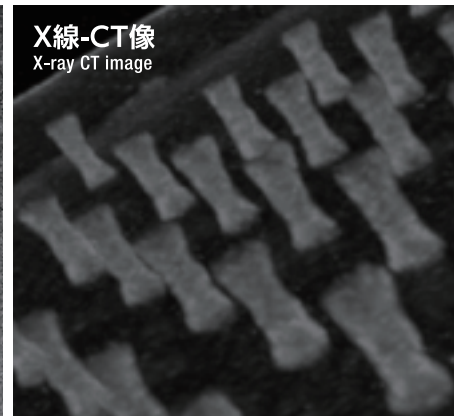
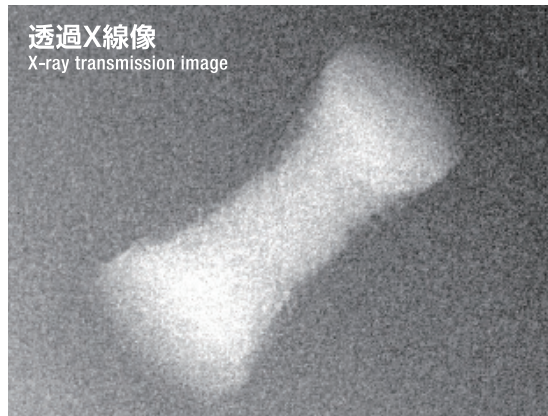
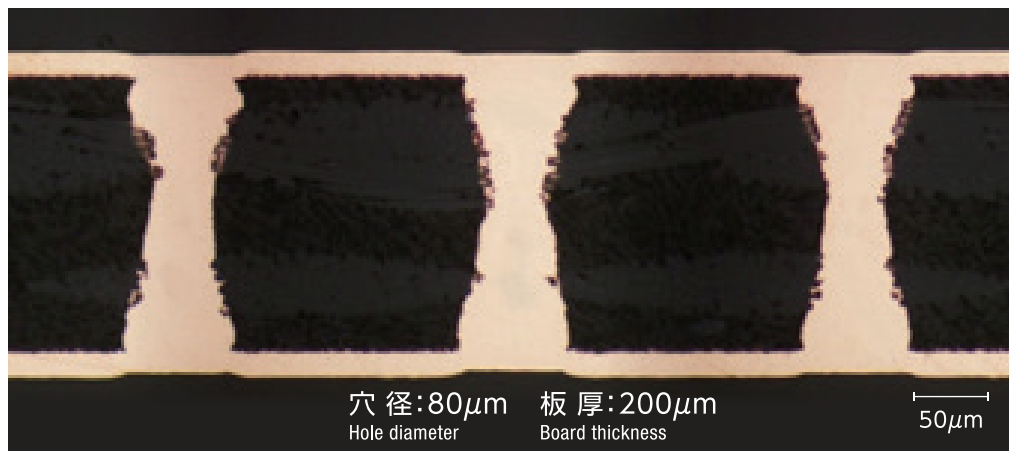
Current density

1.0A/dm²

めっき膜厚

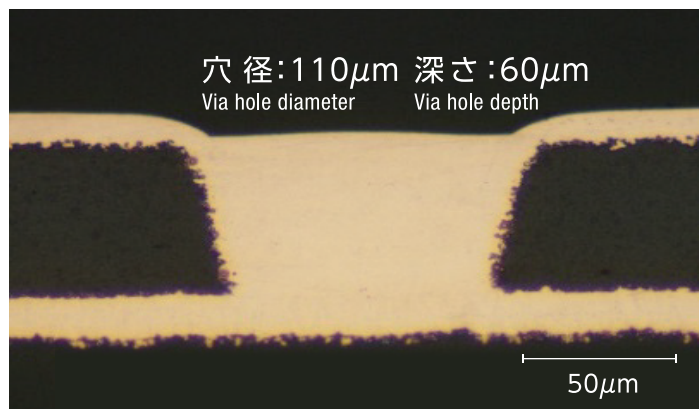
Film thickness

15 μm



ビアフィリングも可能

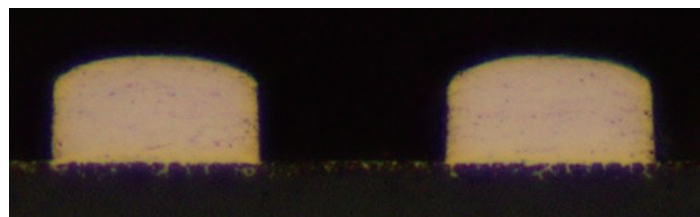
Also, can be used for via filling



めっき膜厚:10 μm
Plating thickness

パターンめっき断面

Cross-section image of pattern plating



L/S=30/30 μm